

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2024-079

深圳同兴达科技股份有限公司 关于子公司签署补充协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告是对公司 2023 年 10 月 19 日已披露的《关于全资子公司引入新股东并增资的公告》的后续进展公告。

一、情况概述

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展先进封测业务及提升其经济实力，与日月新半导体（昆山）有限公司（简称“日月新”）协商一致，于 2023 年 10 月 18 日签订《增资协议》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司引入新股东并增资的公告》（公告编号 2023-063）。

二、签署原因及《补充协议》主要内容

甲方：深圳同兴达科技股份有限公司

乙方：日月新半导体（昆山）有限公司

丙方：昆山日月同芯半导体有限公司

1、主协议签订情况

各方于 2023 年 10 月 18 日签订了《增资协议》（下称“主协议”），现经甲、乙、丙三方协商一致，对如下事项达成协议：

2、补充协议内容

主协议签订后，主协议第一条第2项第（2）款的约定：“2024年12月15日前，乙方将以现有的无尘室车间及配套设施、厂务环氧工程及设备、厂务环保及电力工程设备资产向目标公司完成出资（“第二批出资”），具体价格以评估为准（但届时评估价格不应超过资产原值减去甲方已支付租金后的金额）”。

前述“第二批出资”因资产评估事项需延期，故甲、丙双方同意乙方调整出资时间，乙方就前述第二批出资资产向丙方的出资的时间由“2024年12月15日前”调整为“2024年12月31日前”。

3、各方确认

本补充协议未变更的内容，仍按主协议执行。

4、附则

本补充协议一式三份，经三方盖章后生效，与主协议具有同等法律效力。如本补充协议与主协议存在冲突的，以本补充协议的内容为准。

三、《补充协议》签订后对公司的影响

此次《补充协议》的签订是经公司审慎研究并与对方协商一致的结果，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会影响公司在芯片封装及测试项目的长期部署和战略规划，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《增资协议》之补充协议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日